

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 1 区分
【発行日】平成 19 年 2 月 1 日 (2007.2.1)

【公開番号】特開 2005-181222 (P2005-181222A)
【公開日】平成 17 年 7 月 7 日 (2005.7.7)
【年通号数】公開・登録公報 2005-026
【出願番号】特願 2003-425616 (P2003-425616)
【国際特許分類】

G 0 1 R 31/26 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 31/26 H

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 12 月 6 日 (2006.12.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

以下の工程を含む半導体装置の製造方法：

- (a) 複数の半導体装置が搭載された複数のテストボードが恒温槽に導入されてテストが行われている状態で、テストが終了した 1 枚の前記テストボードを取り出す工程；
- (b) 取り出された前記テストボードから、前記複数の半導体装置をはずす工程；
- (c) 前記半導体装置をはずした前記テストボードに、テストする複数の半導体装置を搭載する工程；
- (d) 前記複数の半導体装置が搭載された前記テストボードを前記恒温槽に導入し、前記導入したテストボードをテストする工程。

【請求項 2】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、

前記複数のテストボードが前記恒温槽に導入されて前記複数の半導体装置のテストが行われている状態で、新たにテストされる複数の半導体装置を前記テストボードに搭載する工程と、

テストが終了した前記テストボードが前記恒温槽から取り出された際に、前記新たにテストされる半導体装置が搭載されたテストボードを前記恒温槽に導入し、テストする工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

請求項 2 記載の半導体装置の製造方法において、

前記恒温槽は、第 1 のスロットと第 2 のスロットとの温度が異なる半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、

第 1 の温度が設定された前記恒温槽において前記テストボードに搭載された半導体装置のテストを行う工程と、

前記第 1 の温度によるテストが終了した後、第 2 の温度が設定された前記恒温槽において前記テストボードに搭載された半導体装置のテストを行う工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 5】

請求項 4 記載の半導体装置の製造方法において、
前記恒温槽を第 1 の温度に設定し、前記半導体装置をテストする工程と、
前記第 1 の温度によるテストが終了すると、前記恒温槽を第 2 の温度に設定し、前記半導体装置をテストする工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 6】

請求項 5 記載の半導体装置の製造方法において、
第 1 の温度による前記半導体装置のテストと第 2 の温度による前記半導体装置をテストとを異なる恒温槽により行う半導体装置の製造方法。

【請求項 7】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、
ハンドラにより、前記テストボードに半導体装置を搭載する工程と、
前記半導体装置を搭載したテストボードを 1 枚毎に前記検査装置の恒温槽に前記ハンドラにより供給する工程と、
テストの終了後に、テスト結果に基づいて冷却された前記半導体装置を前記ハンドラにより分類、収納する工程とを含む半導体装置の製造方法。

【請求項 8】

請求項 7 記載の半導体装置の製造方法において、
前記ハンドラによって前記テストボードに搭載される半導体装置は、第 1 のテストボードと第 2 のテストボードで種類が異なる半導体装置の製造方法。

【請求項 9】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、
前記半導体装置は、ロジックや半導体メモリなどの複数の半導体チップを 1 つのパッケージに収納した S i P 製品よりなる半導体装置の製造方法。